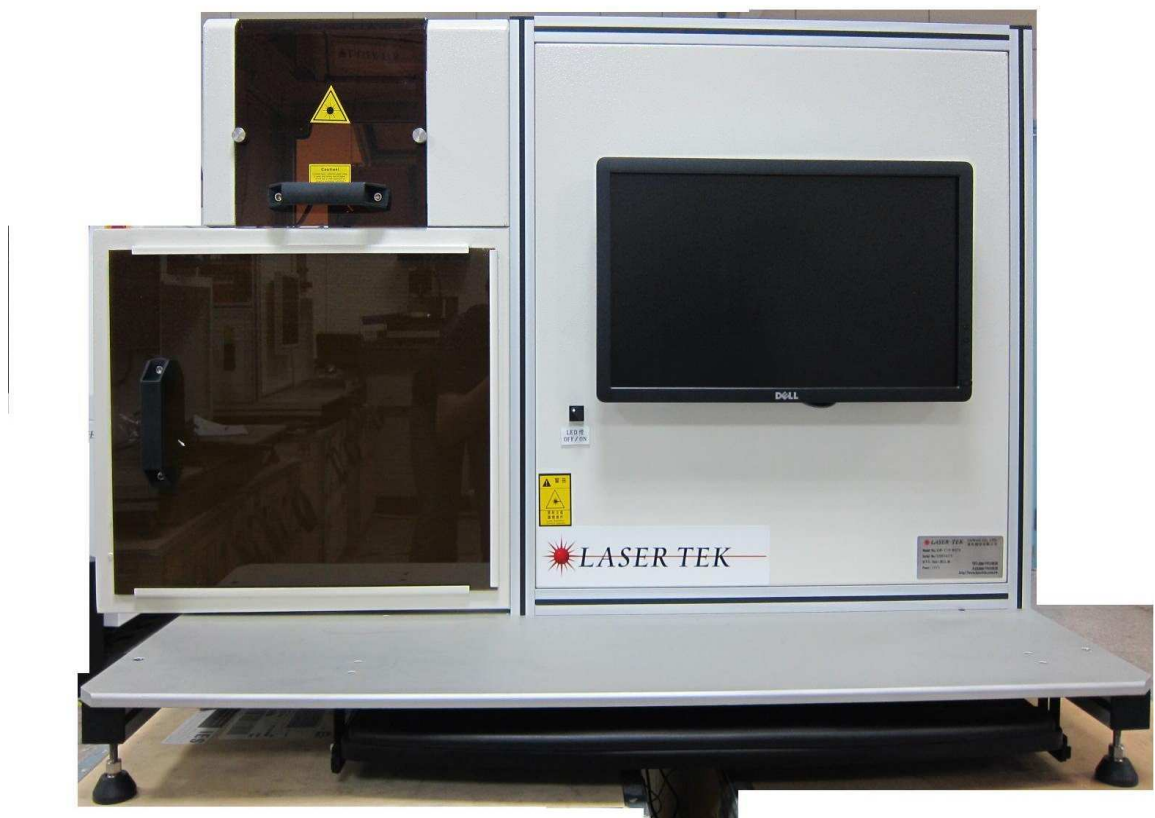




最佳解決方案—
滿足您多樣化需求的鐳射除膠機



尺寸：115x70x75cm 機器重量：150kgs(Approx.)

Laser Marking System LM-C10-MZ70

No. 248-39, Shin-Sheng Road, Chien-Zhen District, Kaohsiung, Taiwan

TEL: +886-7-9510828 FAX: +886-7-9510820

● 鐳射除膠的特色：

- §非接觸式加工，無刀具更換及斷裂磨耗問題。
- §永久性標記，除膠效果精緻美觀，提升產品質感。
- §電腦繪圖，少量打樣免開模製版之困擾。
- §適用材料廣泛，無材料硬度之限制。
- §物件表面不需清潔處理，可直接進行除膠，簡化生產流程。
- §可直接於曲面加工。
- §自動化設計周全，大量小量生產皆適宜。

● 適用材料：

各種非金屬如玻璃、塑膠、壓克力、木材、鍍膜、烤漆、噴漆、電鍍、陽極處理、貼紙...等材料；電子零件、IC、PCB 板、銘板、鈕扣、光碟片、連接器、包裝材料、相框、布料...等產品。

● 特性說明：

- §最新型高速高精度除膠頭，採用德國 Scanlab dynAXIS 系列掃描馬達。
- §紅光導引預覽功能，便於除膠前將物件正確定位。
- §程式控制鐳射功率，並可自動儲存紀錄，後續使用時自動將功率調整至原設定值，無須另行記錄來作為使用參考。
- §全中文設計，30 分鐘即可學會操作，大幅縮短教育訓練的時間。
- §人性化使用者操作介面，簡便易學易用，僅需填入相關參數即可完成設定。
- §強大的繪圖功能，除了基本的線段、圓弧、圓形與矩形外，並有曲線繪圖功能來進行不規則圖形繪製。繪圖完成設定相關參數即可進行除膠，簡化作業流程。
- §功能完整的排版設計，可自由拖拉與縮放尺寸、位置、角度、旋轉、鏡射等，以及各種文字排列與圓弧排列，並可輕易完成矩陣設定做一次多個物件除膠。
- §提供完善的一維條碼與二維條碼除膠，並可使用流水號模式進行條碼除膠。
- §具有群組功能，可將多個物件進行群組，使用共同的鐳射參數以簡化設定。
- §完整的 I/O 設計，可自行規劃各 I/O 之代表功能並透過即時的監控畫面了解 I/O 訊號連結情形，與周邊系統連結簡單容易。

精巧的鐳射除膠系統—

系統整合、自動化的好幫手

詳細規格:

鐳射除膠機尺寸 Size(cm)	115x70x75cm
鐳射波長 Wavelength	10.6 um
鐳射形式 Laser Type	Sealed, RF Excited CO2 Lase
鐳射模式 Beam Mode	TEM00,95% Purity, $M^2 < 1.2$
輸出功率 Output Power (max.)	10 Watts
頻率調變 Pulse Width Modulation	~20KHz
除膠範圍 Field Size (mm)	70X70
鐳射頭尺寸 Dimensions of Laser Head(mm)	760(L)X173(W)X236(H)
鐳射頭重量 Weight of Laser Head(Kg)	15
冷卻需求 Cooling Requirement	風扇強制冷卻
電力需求 Electrical Power	1ϕ100~200VAC , 20/60 Hz , 2.5AMP
控制介面 Control interface	16Bit Analog PCI Bus 或 Bit Digital USB Mode
電腦需求 PC Requirement	Pentium 以上，含光碟機，軟碟機，鍵盤，滑鼠 螢幕，USB Port，PCI Slot

※ 規格因技術需要而變動數不另行通知※